

# 0611强势股脱水 | 景气、通胀、国产化，半导体材料要量价齐升？

2026/06/11 17:36

“

①有色钼：SK海力士新一代3D NAND采用钼替代字线材料，叠加出口管制重塑靶材供应链，钼在半导体领域的增量逻辑首次清晰兑现；传统油气、军工需求受地缘冲突催化持续景气，测算供需缺口将在2028年达到极致，全球钼供给刚性约束难以短期缓解，钼价中枢有望持续上移。

②半导体耗材：全球半导体进入高景气周期，晶圆厂大规模扩产叠加先进制程工艺迭代，CMP、靶材、光刻胶、刻蚀液等关键材料呈现用量与价格双重“通胀”效应；当前我国半导体材料整体国产化率仅15%，具备技术验证积累的头部供应商有望同时获取景气、份额、通胀三重弹性。

③光互联：公司卡位CPO和OCS上游精密光学器件核心环节，光通信业务收入2025年同比增长134%，26年一季度进一步加速至增长218%；全年经营现金流历史性转正，毛利率持续修复，多工艺微纳光学平台构建的技术壁垒使其在AI算力驱动的光互连升级中具备较强的差异化竞争优势。

本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘，相关个股信息仅供参考，不构成投资建议。

## 1、有色钼：韩股专场？

### (1) 大涨题材：有色钼+半导体

媒体报道称，SK海力士现有V9 321L后的下一代3D NAND闪存将采用375层堆叠设计。新的V10 NAND已完成生产验证，正准备量产转移。

其中在技术层面，S属布线层中将部分字线材料从钨替换为钼，后者电阻更低、填充性能更好。在钼沉积工艺中。

受此影响，有色钼板块集体大涨，金钼股份等多股涨停。

01

有色·钼 +8.35%

理由 SK海力士尝试“以钼代钨”，助力NAND性能提升

股票名称	最新价	涨跌幅	涨停时间	换手率	流通市值
金钼股份 601958.SS	23.20	+10.00%	09:38:24	1.46%	748.57亿
盛龙股份 001257.SZ	25.22	+9.99%	10:31:00	24.47%	34.54亿
隆华科技 300263.SZ	14.18	+19.97%	13:13:12	19.98%	138.33亿
欧莱新材 688530.SS	67.06	+20.01%	--	0%	0

### (2) 研报深度复盘（国元证券、长江证券、国金证券）：战略价值重估

①钼在元素周期表中的原子序数为42，纵向位于铬和钨之间，横向位于铌和锆之间；与钒、铼有对角线关系（性质相似）。工业应用中，钼常作为“工业味精”被添加到合金中，能显著提高材料的强度、硬度、耐腐蚀和高温强度，少量的钼即可发挥大作用。由于人类对钼的发现和历程较短，钼在下游领域的拓展还蕴含着巨大的潜力。

②供给端，全球钼矿探矿权和采矿权数量持续收缩，国内行业整体产量较2015年高点已明显下滑；海外铜钼伴生矿存量矿山品位持续衰减，2024年海外矿山钼产量降至16.4万吨，且这一趋势难以在短期逆转。**供需测算显示，钼的供需缺口将自2026年起逐步扩大，至2028年达到极致。**

③军工需求是另一重增量逻辑。钼是坦克、装甲板等军事装备的关键材料，当前海外国防开支持续增加——钼铁库存已处于持续低位，叠加产业链上下游去库加速，钼价“有量无价”的僵局正在打破。与此同时，钨价处于历史高位，镍具有涨价预期，两者互为替代关系，对钼价形成额外支撑。此外，钼在半导体靶材领域的国产化率仍仅约5%。

④金钼股份为行业龙头，矿山自给率100%，持有金堆城钼矿和东沟钼矿两大世界级单体钼矿，钼靶材方面，公司已实现6代OLED整靶国产化，产品通过三星、京东方等11条产线认证，当前正持续加大钼金属研发投入。

## 2、半导体耗材：量价齐升

### (1) 大涨题材：半导体

同样是海力士催化——SK集团董事长表示，计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足日益增长的由人工智能驱动的内存芯片需求。

午后又有消息称，近期SK海力士多家设备一级供应商已提出涨价要求，供货价格涨幅在3%-4%。业内人士透露，SK海力士近期已向多家设备供应商（一线厂商）要求提交“价格调整审核材料”（即证明涨价合理性的文件）。

对于半导体材料来说，一方面，HBM单颗芯片铜靶用量达传统芯片3倍以上。光刻胶方面，7nm及以下多重曝光使单位晶圆消耗量显著增。刻蚀液方面，从65nm到7nm刻蚀步骤激增超300%。另一方面，相关产品国产化需求很强烈。

行情上，太极实业等涨停，龙图光罩等多股大涨。

02

#### 太极实业 600667.SS 新高

半导体（集成电路）市场领先的制造与服务商；公司半导体（集成电路）制造板块主要为半导体封测业务，半导体（集成电路）服务板块主要为电子高科技工程技术服务业务；半导体封测业务依托子公司海太半导体和太极半导体开展，其中海太半导体从事半导体产品的封装、封装测试、模组装配和模组测试等业务；太极半导体从事半导体产品的封装及测试、模组装配，并提供售后服务

17.51

首板

+9.99%  
11:18 涨停

#### 耐科装备 688419.SS

国内为数不多的半导体封装设备及模具国产品牌供应商之一；公司主要从事应用于半导体封装及塑料挤出成型领域的智能制造装备的研发、设计、制造和服务，为客户提供定制化的智能制造装备及系统解决方案；公司主要产品为应用于半导体封装及塑料挤出成型领域的智能制造装备，具体为半导体封装设备及模具、塑料挤出成型模具、挤出成型装置及下游设备，其中，半导体封装设备产品主要为半导体全自动塑料封装设备、半导体全自动切筋成型设备等

55.08

首板

+20.00%  
13:00 涨停

#### 华特气体 688268.SS 拟减持

国内领先的半导体特种气体供应商；公司主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案；公司集成电路领域电子特种气体产品实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯二氟甲烷、高纯八氟丙烷、锆烷、高纯乙烷、高纯甲烷、高纯六氟丁二烯等众多产品的进口替代

228.82

首板

+20.00%  
13:20 涨停

#### 阿石创 300706.SZ 扭亏

国内PVD镀膜材料行业设备齐全、技术先进、产品多元化的龙头企业之一；公司专业从事PVD镀膜材料的研发、生产与销售，自主研发200多款高端镀膜材料，产品覆盖半导体等多个领域

67.88

首板

+19.99%  
13:20 涨停

## (2) 研报深度复盘 (财通证券、华泰证券、光大证券)：景气、通胀、国产化

①半导体材料板块当前所处的时间节点，并不只是简单的景气向上，而是**景气上行、先进工艺通胀、份额提升、国产化四重驱动同时共振**。

其中“工艺通胀”是最值得关注的结构性增量：先进逻辑、HBM、3D NAND的迭代，不仅带来晶圆片数增长，更在CMP、靶材、光刻胶、刻蚀液、清洗液等关键材料环节形成规格升级和单片用量提升的“通胀”效应——例如3D NAND从128层升至232层以上时，单片晶圆靶材消耗量增加超40%；逻辑芯片从250nm缩至7nm时，CMP抛光步骤从8次增至30次。这意味着即使晶圆厂产能不扩张，材料消耗量也会随工艺迭代持续增长。

②2026年存储行业增速显著提速，长鑫上海新厂预计2026年下半年设备进场，长江存储武汉三期有望提前至2026年下半年启动量产；台积电2026年资本开支上修至520-560亿美元；中芯国际2025年平均产能利用率达93.5%，四季度达95.7%。2025年全球半导体材料市场销售额达732亿美元，同比增长6.8%，创历史新高。

③国内半导体材料整体国产化率仅约15%，高端领域严重依赖日本供应商，而当前中日经贸+安全博弈升级，正在将国产化的驱动力从“成本和性能”升级为“供应链安全优先”。以光刻胶为例，日本JSR、TOK等五家企业垄断全球约95%市场，我国KrF光刻胶国产化率仅约3%，ArF不足1%，EUV几乎为零，若高端光刻胶纳入出口管制，替代迫切性将急剧上升。湿电子化学品领域，高纯刻蚀液市场仍集中于海外，叠加上游含氟电子特气出口管控趋严，国内量产能力强的企业有望加速导入。

④半导体材料行业的竞争格局正在发生一个结构性转变，行业逻辑从“产能扩张”转向“技术验证+长期绑定”，具备产线验证基础和客户认证积累的头部企业，竞争壁垒将持续强化。

相关产业链：

CMP材料：鼎龙股份，安集科技。

靶材：江丰电子。

光刻胶：彤程新材，鼎龙股份，晶瑞电材，南大光电，东材科技，上海新阳，雅克科技，艾森股份。

湿电子化学品：兴福电子，晶瑞电材，中巨芯-U，江化微，飞凯材料，安集科技，格林达。

电子特气：华特气体，昊华科技，金宏气体，中船特气，雅克科技，和远气体，广钢气体，侨源股份。

其他：国瓷材料（5N级高纯氧化铝）。

## 3、炬光科技：无视行业噪音

### (1) 大涨题材：光通信+半导体

近日，工信部印发《“人工智能+信息通信”创新发展实施意见（2026—2028年）》。其中提到，加强高端光电芯片和器件研发。加强高速光电芯片、高速转发/交换芯片、全光交换器件、光电共封装器件等技术和产品研发验证，加强智算超节点光电互联技术攻关。

公司围绕光源准直、聚焦和光纤耦合等环节提供核心无源光器件，已应用于传统光模块、OCS、CPO等场景，此外，公司产品还用于OLED激光退火、Mini-LED修复系统等泛半导体制程。

行情上，公司今日20%涨停。



## (2) 研报深度复盘 (国盛证券、东北证券、长江证券)：卡位核心器件

①从光互连技术趋势看，OCS和CPO的推进并非遥远预期：NVIDIA已分别向Lumentum和Coherent各投资20亿美元并签署多年采购承诺；谷歌Apollo项目大规模部署MEMS型OCS已被证明可有效降低功耗与成本，并被应用于TPU v4集群以缩短大型语言模型训练时间。

②公司在光模块产业链的独特卡位——为光模块提供“调控光子”的上游精密光学器件，包括传统光模块的微透镜、CPO场景中的V型槽和微棱镜透镜阵列，以及OCS场景中的N×N大透镜阵列。

这一地位决定了公司受益于整个光通信技术升级的长期趋势，而非依赖单一产品周期。公司CPO业务中V型槽项目工艺已取得较大突破，能完全满足CPO装配中的高精度需求，目前客户样件在交付中；OCS相关产品N×N大透镜阵列已实现小批量出货，进入产能爬坡阶段。

③公司2025年研发投入达1.71亿元，同比大幅增长80.09%，高度集中于光通信高通道数V槽、蚀刻微棱镜、CPO光学组件，以及消费电子的晶圆级光学方向。高强度研发短期形成费用压力，但已有效建立多工艺微纳光学平台的技术壁垒——公司掌握晶圆级同步结构化、光刻-反应离子蚀刻、晶圆级微纳光学压印等多种制备技术，可同时满足CPO及OCS对精度、一致性和量产能力的综合要求，构筑了较高的技术护城河。

研报来源

国元证券，马捷，S0020522080002，金钼股份——资源完全自给，钼产业链布局日趋完善，2026年4月30日。

长江证券，王鹤涛，S0490512070002，小金属钼专题：油气军工金属，战略价值重估，2026年5月12日。

国金证券，有色金属行业周报：钨价第二波蓄势、看好钼价上涨，2026年5月31日。

财通证券，唐佳，S0160525110002，半导体材料——景气上行叠加工艺通胀，国产替代开启成长新篇，2026年4月13日。

华泰证券，庄汀洲，S0570519040002，需求旺盛下半导体材料景气或加速，2026年5月18日。

光大证券，赵乃迪，S0930517050005，全球半导体销售额屡创新高，高景气下半导体材料需求持续提振——基础化工行业周报（20260511-20260515），2026年5月16日。

国盛证券，余凌星，S0680525010004，炬光科技——微光学器件龙头，CPO&OCS打开成长空间，2026年4月12日。

东北证券，李玖，S0550522030001，炬光科技——光通信业务持续加速，半导体光学迎爆发时刻，2026年5月11日。

长江证券，杨洋，S0490517070012，炬光科技——新兴业务全线高增，盈利拐点渐行渐近，2026年5月16日。

\*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

\*风险提示：股市有风险，入市需谨慎

本资讯中的内容来自持牌证券机构，意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖做出保证。投资者不应将本资讯作为投资决策的唯一参考因素。亦不应以本资讯取代自己的判断。

本文内容和观点不代表选股通APP平台观点，请独立判断和决策。在任何情况下，选股通APP不对任何人因使用本平台中的内容所引致的任何损失负任何责任。